(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005年9月15日(15.09.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/085154 A1

(51) 国際特許分類7:

C04B 35/468, H01B 3/12

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2005/003628

(22) 国際出願日:

2005年3月3日(03.03.2005)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2004-061713 2004年3月5日(05.03.2004)

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 宇部 興産株式会社 (UBE INDUSTRIES, LTD.) [JP/JP]; 〒 7558633 山口県宇部市大字小串1978番地の96 Yamaguchi (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 河野 孝史 (KAWANO, Takafumi) [JP/JP]; 〒7558633 山口県宇部 市大字小串1978番地の5 宇部興産株式会社 宇 部研究所内 Yamaguchi (JP). 山永 正孝 (YAMANAGA, Masataka) [JP/JP]; 〒7558633 山口県宇部市大字小串 1978番地の5宇部興産株式会社宇部研究所内 Yamaguchi (JP). 福田 晃一 (FUKUDA, Koichi) [JP/JP];

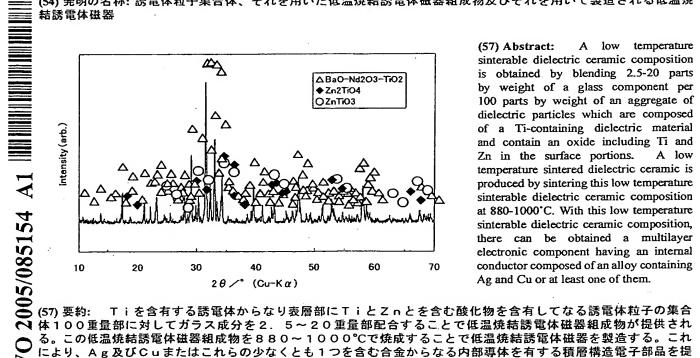
〒7558633 山口県宇部市大字小串1978番地の5 宇部興産株式会社 宇部研究所内 Yamaguchi (JP).

- (74) 代理人: 山下 穣平 (YAMASHITA, Johei); 〒1050001 東京都港区虎ノ門五丁目13番1号虎ノ門40MT ビル 山下国際特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FL, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NL NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護 が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CL, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

/続葉有]

(54) Title: DIELECTRIC PARTICLE AGGREGATE, LOW TEMPERATURE SINTERABLE DIELECTRIC CERAMIC COM-POSITION USING SAME, LOW TEMPERATURE SINTERED DIELECTRIC CERAMIC PRODUCED BY USING SAME

(54) 発明の名称: 誘電体粒子集合体、それを用いた低温焼結誘電体磁器組成物及びそれを用いて製造される低温焼 結誘電体磁器



る。この低温焼結誘電体磁器組成物を880~1000℃で焼成することで低温焼結誘電体磁器を製造する。これ により、Ag及びCuまたはこれらの少なくとも1つを含む合金からなる内部導体を有する積層構造電子部品を提 供することができる。

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。